

第 47 回 信頼性・保全性シンポジウム 展示企業の出展内容

| | | | |
|-------|-------------------------------------|-----|---------------|
| 出展企業 | 内藤電誠工業株式会社 設計・評価事業部 評価解析部 | | |
| E-メール | ndkz-hyouka@ndk-reliability-lab.com | | |
| TEL | 044-811-5496 | 担当者 | 評価営業：山崎／金坂／後藤 |

弊社では、各種信頼性試験・環境試験及び調査解析(物理解析・断面解析)受託サービスでお客様の品質向上をサポート致します

信頼性評価 ONE STOP Service

内藤電誠グループ

- 耐熱性・耐寒性試験
- 導体抵抗モニタシステム
- ハイパワー・恒温恒湿試験
- 温度サイクル試験
- 電気加速試験
- 可動部信頼性試験
- 熱抵抗測定
- 熱画像
- 3D画像

導体抵抗モニタシステム

染色試験(Dye & Pry)

前処理試験

リポール

熱抵抗測定システム/シミュレーション

調査解析 ONE STOP Service

内藤電誠グループ

- 引継解析
- 電気的特性解析
- X線CT観測
- マイクロラーパスX線観測
- 超音波探傷(SAT)解析
- 銅ワイヤー開封
- 断面加工/SEM観察/EDX分析
- 平面解析
- LED開封

次世代パワー半導体の信頼性試験

お客様が満足して頂ける受託信頼性サービスを提供いたします

次世代パワー半導体(SiC GaN)次期使用領域

電圧で動作するため冷却機器を小さくし機器の小形化ができる

大型機器だけではなく家電の様な小型機器にも使用される

次世代パワー半導体の耐熱信頼性評価に最適です。

300℃対応冷熱衝撃試験槽

幅広い温度制御範囲
低温側 -70℃~0℃
高温側 +300℃~+650℃⇒従来機(Max+200℃)
高温領域の拡大制御が可能です。

ハイパワー恒温恒湿試験槽

幅広い温度制御範囲
低温側 -75℃、高温側+180℃、湿度10~99%rh
覆れた温度上昇・下降速度
約1℃/分の温度サイクルを制御(-75℃~+180℃)
駆動周波の温度変化: 約4℃分(-49.5℃~+164.5℃)

電子デバイスの物理解析

お客様の品質向上をサポートいたします

電子部品の特性測定・非破壊～破壊解析

- 振動試験
- V-I特性
- 外観観察
- 特性測定
- 非破壊解析
- X線CT観測
- 超音波探傷

半破壊解析

- PKG開封
- ドライエッチング
- 破壊解析
- 感度解析
- SEM/EDX

マルチフォーカスX線CT観察事例(非破壊解析)

スマートフォン コネクタ不良の観察

＜現状＞
USB接続によるデータアクセスや充電が正常にできなくなった為、コネクタに着目しX線CT観察を行った事例です。
このように、非破壊でコネクタの端子折れ、変形が確認できます。

X線透視観察

X線CT観察

＜コネクタ端子平面断面＞

- 端子折れ
- 端子の変形

＜コネクタの断面＞

- 端子の変形
- 端子折れ

＜端子変形の断面＞

＜3D像＞